

Wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca

PCI Pericol® Flex Plus

do wszystkich okładzin ceramicznych

PCI®
Für Bau-Profis



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian i posadzek.
- Do wyklejania we wnętrzach i na zewnątrz budynków chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, gresu itp. na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastriko, płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe i OSB, zespolone uszczelnienia podpłytkowe (np. PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Barraseal®, PCI Apoflex®, PCI Pecilastic®), stare powłoki malarskie i stare okładziny płytkowe, ogrzewania podłogowe i ściennie.
- Do klejenia płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia.
- Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych i mokrych (łazienkach, umywalniach), na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływackich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury.
- Do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie grubości 1 do 5 mm.
- Do przyklejania płyt wykonanych z polistyrenu ekspandowanego (styropianu), polistyrenu ekstrudowanego (np. Styrodur C), wełny mineralnej oraz płyt kompozytowych.
- Szczególnie zalecana do przyklejania okładzin na podłożach krytycznych oraz do płyt wielkoformatowych (o długości boku > 1 m lub o powierzchni > 1 m²).
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.



1020, 1390

**BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim**

16
CZ0124/01

**PCI Pericol® FlexPlus (CZ0124/01)
EN 12004**

Improved deformable cementitious
adhesive for internal and external tiling
EN 12004 C2TE

Reaction to fire	Class A2/A2 _n
Initial tensile adhesion strength	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycle	≥ 1.0 N/mm²
Dangerous substances	Comply with 4.5 EN 12004

A brand of

BASF

We create chemistry

Właściwości produktu

- Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN-EN 12004.
- Brak spływu na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia.
- Mrozo- i wodoodporna.
- Do warstw o grubości: 1 do 5 mm.
- Wykazuje **bardzo wysoką przyczepność** do różnych podłoży i różnych okładzin, także niechłonnych i gładkich (np. beton monolityczny wykonany w gładkim deskowaniu, płytki gresowe).
- **Wysoko-elastyczna (S1)** – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża wynikające np. z dużych zmian temperatury.
- **Plastyczna** - łatwa w obróbce.

Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatków; nie zawiera azbestu ani innego rodzaju włókien mineralnych
Składniki	produkt 1-składnikowy
Konsystencja	plastyczna
Kolor	szary
Składowanie	w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30°C
Trwałość składowania	12 miesięcy
Gęstość nasypowa	ok. 1,5 kg/dm ³
Gęstość świeżej zaprawy	ok. 1,6 kg/dm ³
Opakowanie	wzmocniony worek papierowy 25 kg z wkładem polietylenowym
Zużycie:*	
Paca zębata	Zużycie/m ²
4 mm	ok. 2,0 kg
6 mm	ok. 3,0 - 4,0 kg
8 - 10 mm	ok. 4,0 - 6,0 kg
Zużycie na 1 mm grubości warstwy	ok. 1,35 kg
Temperatura aplikacji i podłoża	+5°C do +25°C
Ilość wody zarobowej:	
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,24 - 0,26 l
- na worek 25 kg	ok. 6,0 - 6,5 l
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty
Czas użycia**	ok. 90 minut
Czas otwarty klejenia**	ok. 30 minut
Czasy utwardzania:**	
- możliwość wchodzenia po	ok. 12 godzinach
- możliwość spoinowania po	ok. 12 godzinach
- pełne obciążenie po	ok. 3 dniach
Grubość warstwy kleju	1 do 5 mm
Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Spływ	≤ 0,5 mm
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Reakcja na ogień	A2/A2 _{fl}

* Na zużycie PCI Pericol® Flex Plus wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża. W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

** Przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
 - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
 - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
 - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
 - tradycyjne tynki cementowe: ok. 28 dni;
 - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®. Do równania ścian można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Polycrret® K40, PCI Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC lub PCI Barrafill® 305.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1 : 1 z wodą. Podłoża gipsowe zagruntować

nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.

- Podłoża niechłonne (np. stare farby olejne, stare okładziny płytkowe, lastryko, płyty OSB) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® 404.
- Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych gruntować środkiem PCI Wadian®.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą CM, powinna wynosić dla:
 - podłoży cementowych: 4%;
 - dla podłoży gipsowych: 0,5%.

Sposób użycia

Przygotowanie zaprawy klejowej

1 Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 500 obr./min.) do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.

2 Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszać.

Wyklejanie okładzin

- 3** Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.
- 4** Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku)

na świeżą warstwę kontaktową zaprawę klejową. Nanosić tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszkami palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.

5 Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Pericolor® Flex, PCI Nanofug®,

PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox® NT plus.

- Spoiny dylatacyjne wypełnić właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 100.

Zalecenia i uwagi

- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament® lub PCI Carraflex®. W razie wątpliwości co do właściwości danego kamienia, zaleca się wykonanie próbnego przyklejenia i na tej podstawie dobranie odpowiedniej zaprawy klejowej.
- Na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniach podłogowych i ściennych, w basenach pływakich i kąpielowych oraz w przypadku okładzin płytkowych poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym (np. naciskom kół pojazdów czy podpór ciężkich elementów wyposażenia), należy zastosować klejenie metodą kombinowaną lub użyć zaprawy płynnowarstwowej PCI Pericol® Fluid, celem zapewnienia podklejenia min. 95% powierzchni płytki.
- Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym należy przed wyklejaniem

okładzin płytkowych poddać wstępnemu wygrzewaniu.

- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.

- Przed spoinowaniem usunąć spo- między płytek jeszcze w stanie świe- żym resztki zaprawy klejowej.
- Płyty termoizolacyjne mogą być generalnie przyklejane metodą „na placki”, chyba, że przewiduje się na nich dodatkowe warstwy materia- łów. Wówczas konieczne jest przy- klejanie pełnopowierzchniowe.
- Przed przyklejaniem płyt polisty- renowych należy przetrzeć ich spodnią powierzchnię szczotką dru- cianą w celu poprawy przyczepności zaprawy klejącej.
- Nie stosować do przyklejania płyt polistyrenowych na podłożach bitumicznych.
- W przypadku klejenia płyt termoizola- cyjnych na sufitach stosować dodat- kowe dyblowanie ich do podłoża.
- Narzędzia należy umyć wodą bez- pośrednio po użyciu, gdyż później może być konieczne czyszczenie mechaniczne.

Wskazówki BHP

Zawiera cement. Możliwe jest wystą- pienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz dłu- gotrwałego kontaktu ze skórą. Nie

wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przy- padku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić

odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charak- terystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon 61 636 63 00
faks 61 636 63 14
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem się nowego wydania karty technicznej.
Wydanie sierpień 2016.